

超配（维持）

AI 驱动算力、终端齐飞，设备、材料自主可控强化

半导体行业 2024 年报&2025 年一季报业绩综述

2025 年 5 月 8 日

投资要点：

分析师：刘梦麟

SAC 执业证书编号：

S0340521070002

电话：0769-22110619

邮箱：

liumenglin@dgzq.com.cn

分析师：陈伟光

SAC 执业证书编号：

S0340520060001

电话：0769-22119430

邮箱：

chenweiguang@dgzq.com.cn

■ **半导体板块整体业绩：行业景气整体上行，板块2024年、2025年一季度营收、归母净利润均实现同比增长。**受益AI驱动需求复苏和关键领域国产替代持续推进，半导体行业自2023年下半年以来逐步进入景气复苏周期，并在2024年、2025年一季度维持复苏态势，带动2024年、2025Q1营收、归母净利润均实现同比正向增长。盈利能力方面，板块2024年盈利能力仍处于周期底部水平，销售毛利率、净利率相比2023年略有下滑，但行业自2024年下半年起盈利能力已逐步修复，并于25Q1实现同比正向增长。一季度为半导体行业传统淡季，但在算力类芯片供不应求、消费类芯片需求回暖以及设备、材料、零部件等环节自主可控加速推进等多方面因素加持下，半导体行业2025年一季度整体呈现“淡季不淡”特征，营收、净利润实现同比增长，且盈利能力有所提高。

■ **细分板块业绩：1) 半导体设备：国产替代持续推进、营收、利润双双增长。**受益国内Fab厂、OSAT厂持续扩产，叠加各品类设备中标份额提高，半导体设备板块2024年、2025年一季度营收、归母净利润实现同比增长，行业国产化进程持续推进。盈利能力方面，2024年、2025年一季度半导体设备板块销售毛利率、净利率同比均有所下滑，但整体维持相对稳定。据日本半导体制造装置协会数据，中国大陆2024年半导体设备销售额为495.4亿美元，同比增长35.37%，销售远高于全球平均水平，占全球比重也从2015年的13.42%提升至42.29%，行业产值向中国大陆转移趋势明显。

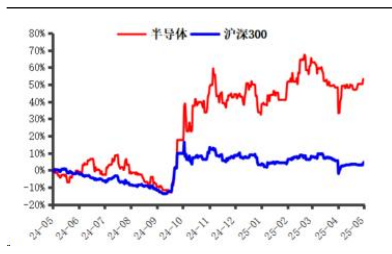
2) **半导体材料：25Q1盈利回升，板块迎来业绩拐点。**受益半导体市场复苏以及高性能计算、高带宽内存制造对先进材料需求不断增长，2024年半导体材料市场收入实现同比增长。大陆半导体材料企业在快速响应、生产成本方面具有一定优势，整体国产化率较低，伴随内资晶圆厂资本开支实现增长，2024年营业收入实现同比增长，但以沪硅产业为代表的硅片大厂持续扩充300mm硅片产能拖累整体毛利率，影响板块利润表现；2024年一季度，受益行业持续复苏，半导体材料板块迎来利润拐点，营收、归母净利润实现同比增长，且盈利能力有所回升；

3) **数字芯片设计：AI拉动算力增长，“国补”释放消费需求。**2024年，AI上游算力需求持续紧张，“国补”落地驱动智能手机、PC等终端需求回暖，叠加AI眼镜、AR/VR等智能终端渗透率持续提升，带动数字芯片设计板块营收、净利润实现同比增长。

4) **模拟芯片设计：工控、汽车开始复苏，龙头企业结构优化。**2024年全球模拟芯片行业呈现“U”型特征，全年整体业绩承压，尤其是工业、汽车等细分市场需求疲软，行业去库存缓慢。虽然板块全年营收实现同比增长，但归母净利润同比大幅下滑。进入2024年下半年以来，以消费电子为代表的细分市场开始回暖，且汽车、通信、工业需求开始恢复，行业景气度开始回升。此外，国内模拟芯片上市企业开始向汽车、工业等高附加值领域拓展业务，带动板块25Q1经营业绩、销售净利率实现同比提高。

5)

半导体行业（申万）指数走势



资料来源：东莞证券研究所，iFind

相关报告

本报告的风险等级为中高风险。

本报告的信息均来自已公开信息，关于信息的准确性与完整性，建议投资者谨慎判断，据此入市，风险自担。

请务必阅读末页声明。

半导体封测：龙头企业经营稳健，全年营收逐季改善。半导体封测板块2024年、2025年一季度营收、归母净利润实现同比增长，且盈利能力维持相对稳定。长电科技、通富微电、华天科技三家企业2024年营收均呈逐季改善态势，且25Q1营收均实现同比正向增长；盈利能力方面，三家企业2024年以来单季度销售毛利率维持稳定，且25Q1毛利率相比上年同期均实现提升，表明行业整体经营态势良好。

6) 分立器件：下游需求弱势复苏，25Q1利润回升。受全球纯电车销售增长放缓等影响，2024年功率半导体市场景气低迷，行业去库存进展缓慢，海外英飞凌、瑞萨、WolfSpeed等大厂均通过削减员工数量来收缩产能。进入2025年一季度，受益国补政策提振消费需求，叠加汽车芯片等高附加值领域国产化率持续提高，行业库存实现缓慢去化，部分功率半导体价格得以修复，分立器件板块经营业绩呈现小幅复苏，板块净利润同比回暖，且毛利率、净利率相比上年同期有所提高。

7) 集成电路制造：成本上升拖累利润端表现，大力扩产助力长期增长。集成电路制造板块2025年营收同比增长15.89%，归母净利润同比下滑36.39%，虽然受益行业复苏，中芯国际、华虹公司等企业2024年实现晶圆销售数量增长，但行业竞争激烈导致产品价格下跌，且资本开支加大导致成本端压力高企，拖累板块全年业绩表现。业绩展望方面，中芯、华虹对25Q1业绩展望乐观积极，均预计2025年一季度销售收入实现环比增长。近年来，受益于产能扩张、技术进步和政策支持，内资晶圆厂营收不断攀升，话语权逐步提高，对上游国产设备、材料形成拉动作用。

- **投资建议：AI渗透与国产替代趋势明确，维持半导体板块超配评级。**受益AI驱动需求复苏和关键领域国产替代持续推进，半导体行业自2023年下半年以来逐步进入景气复苏周期，且2024年、2025年一季度营收、净利润维持增长态势，盈利能力也从2024年下半年开始逐步修复，并于25Q1实现同比正向增长。建议从成长空间和长期确定性出发，把握25Q1业绩表现较好的半导体设备与材料、AI算力、AI终端芯片、模拟芯片、半导体封测等细分板块。
- **风险提示：终端需求不及预期、国产替代不及预期、价格竞争加剧等。**

目录

1. 半导体行业整体业绩：2024 同比增长，25Q1 淡季不淡	5
2. 细分板块业绩情况	6
2.1 半导体设备：国产替代持续推进、营收、利润双双增长	6
2.2 半导体材料：25Q1 盈利回升，板块迎来业绩拐点	9
2.3 数字芯片设计：AI 拉动算力增长，“国补”释放消费需求	12
2.4 模拟芯片设计：工控、汽车开始复苏，龙头企业结构优化	15
2.5 半导体封测：龙头企业经营稳健，全年营收逐季改善	17
2.6 分立器件：下游需求弱势复苏，25Q1 利润回升	20
2.7 集成电路制造：成本上升拖累利润端表现，大力扩产助力长期增长	22
3. 投资建议	24
4. 风险提示	25

插图目录

图 1：半导体板块 2020 年-2024 年营收情况	5
图 2：半导体板块 2020 年-2024 年归母净利润情况	5
图 3：半导体板块 2021Q1-2025Q1 营收情况（不含中芯、华虹）	5
图 4：半导体板块 2021Q1-2025Q1 归母净利润情况（不含中芯、华虹）	5
图 5：半导体板块 2020 年-2024 年毛利率、净利率（%）	6
图 6：半导体板块 2021Q1-2025Q1 毛利率、净利率（不含中芯、华虹）	6
图 7：半导体设备板块 2020 年-2024 年营收情况	6
图 8：半导体设备板块 2020 年-2024 年归母净利润情况	6
图 9：半导体设备板块 2021Q1-2025Q1 营收情况	7
图 10：半导体设备板块 2021Q1-2025Q1 归母净利润情况	7
图 11：半导体设备板块 2020 年-2024 年毛利率、净利率（%）	7
图 12：半导体设备板块 2021Q1-2025Q1 毛利率、净利率（%）	7
图 13：中国大陆半导体设备年度销售金额及同比增长率	8
图 14：中国大陆半导体设备市场规模占全球比重（2014-2024 年）	8
图 15：半导体材料板块 2020 年—2024 年营收情况	9
图 16：半导体材料板块 2020 年—2024 年归母净利润情况	9
图 17：半导体材料板块 2021Q1-2025Q1 营收情况	9
图 18：半导体材料板块 2021Q1-2025Q1 归母净利润情况	9
图 19：半导体材料板块 2020 年—2024 年毛利率、净利率（%）	10
图 20：半导体材料板块 2021Q1-2025Q1 毛利率、净利率（%）	10
图 21：2024 年全球半导体材料收入情况（按地区，金额单位：百万美元）	11
图 22：数字芯片设计板块 2020 年—2024 年营收情况	12
图 23：数字芯片设计板块 2020 年—2024 年归母净利润情况	12
图 24：数字芯片设计板块 2021Q1-2025Q1 营收情况	12
图 25：数字芯片设计板块 2021Q1-2025Q1 归母净利润情况	12
图 26：数字芯片设计板块 2020 年—2024 年毛利率、净利率（%）	12
图 27：数字芯片设计板块 2021Q1-2025Q1 毛利率、净利率（%）	12
图 28：全球智能手机季度出货量	13
图 29：国内智能手机月度出货情况	13

图 30: 模拟芯片设计板块 2020 年—2024 年营收情况	15
图 31: 模拟芯片设计板块 2020 年—2024 年归母净利润情况	15
图 32: 模拟芯片设计板块 2021Q1-2025Q1 营收情况	16
图 33: 模拟芯片设计板块 2021Q1-2025Q1 归母净利润情况	16
图 34: 模拟芯片设计板块 2020 年—2024 年毛利率、净利率 (%)	16
图 35: 模拟芯片设计 2021Q1-2025Q1 毛利率、净利率 (%)	16
图 36: 半导体封测板块 2020 年—2024 年营收情况	18
图 37: 半导体封测板块 2020 年—2024 年归母净利润情况	18
图 38: 半导体封测板块 2021Q1-2025Q1 营收情况	18
图 39: 半导体封测板块 2021Q1-2025Q1 归母净利润情况	18
图 40: 半导体封测板块 2020 年—2024 年毛利率、净利率 (%)	18
图 41: 半导体封测板块 2021Q1-2025Q1 毛利率、净利率	18
图 42: 部分半导体封测企业 2024Q1-2025Q1 营收 (亿元)	19
图 43: 部分半导体封测企业 2024Q1-2025Q1 销售毛利率 (%)	19
图 44: 分立器件板块 2020 年—2024 年营收情况	20
图 45: 分立器件板块 2020 年—2024 年归母净利润情况	20
图 46: 分立器件板块 2021Q1-2025Q1 营收情况	20
图 47: 分立器件板块 2021Q1-2025Q1 归母净利润情况	20
图 48: 分立器件板块 2020 年—2024 年毛利率、净利率 (%)	20
图 49: 分立器件板块 2021Q1-2025Q1 毛利率、净利率	20
图 50: 集成电路制造板块 2020 年—2024 年营收情况	22
图 51: 集成电路制造板块 2020 年—2024 年归母净利润情况	22
图 52: 集成电路制造板块 2020-2024 年销售毛利率、净利率	23
图 53: 2024 年专属晶圆代工厂营收排名 (单位: 亿元)	24

表格目录

表 1: 重点公司盈利预测及投资评级 (截至 2025/5/8)	25
--	----

1. 半导体行业整体业绩：2024 同比增长，25Q1 淡季不淡

半导体板块整体业绩：行业景气整体上行，板块 2024 年、2025 年一季度营收、归母净利润均实现同比增长。选取申万分类标准（2021）下“SW 电子——SW 半导体”的所有上市公司共计 162 家，统计半导体板块 2024 年全年和 2025 年第一季度业绩情况。截至 2025 年 4 月 30 日，除中芯国际、华虹半导体未披露 2025 年一季报外，申万半导体板块其他所有上市公司 2024 年年报、2025 年一季报均已披露完毕。半导体行业所有上市公司 2024 年实现营业收入合计 6,022.25 亿元，同比增长 21.10%，实现归母净利润 353.41 亿元，同比增长 12.82%；半导体行业所有上市公司（不含中芯国际、华虹半导体）2025Q1 实现营收 1,281.31 亿元，同比增长 14.35%，2025Q1 实现归母净利润 79.04 亿元，同比增长 28.75%。

图 1：半导体板块 2020 年-2024 年营收情况

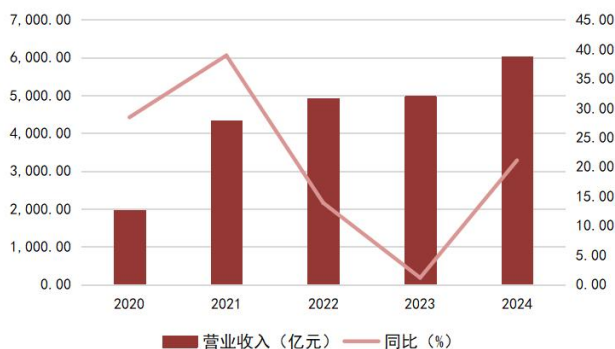
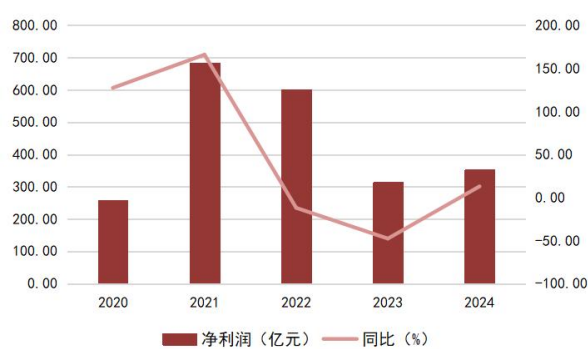


图 2：半导体板块 2020 年-2024 年归母净利润情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 3：半导体板块 2021Q1-2025Q1 营收情况（不含中芯、华虹）

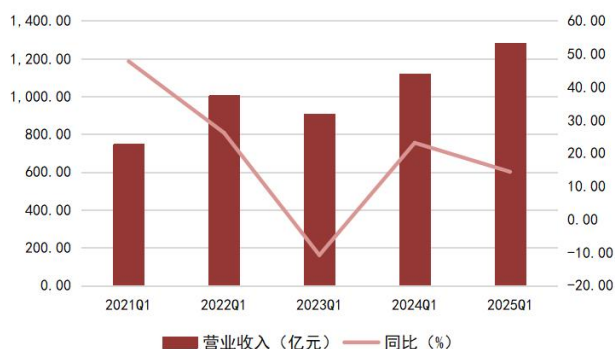
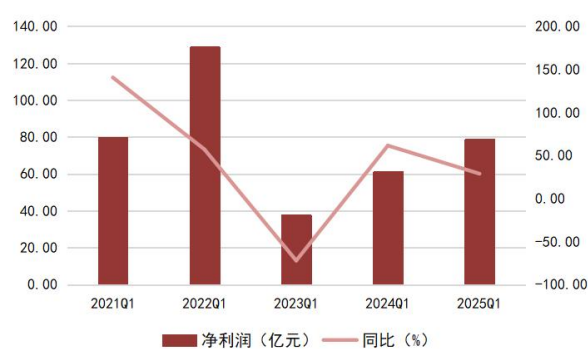


图 4：半导体板块 2021Q1-2025Q1 归母净利润情况（不含中芯、华虹）

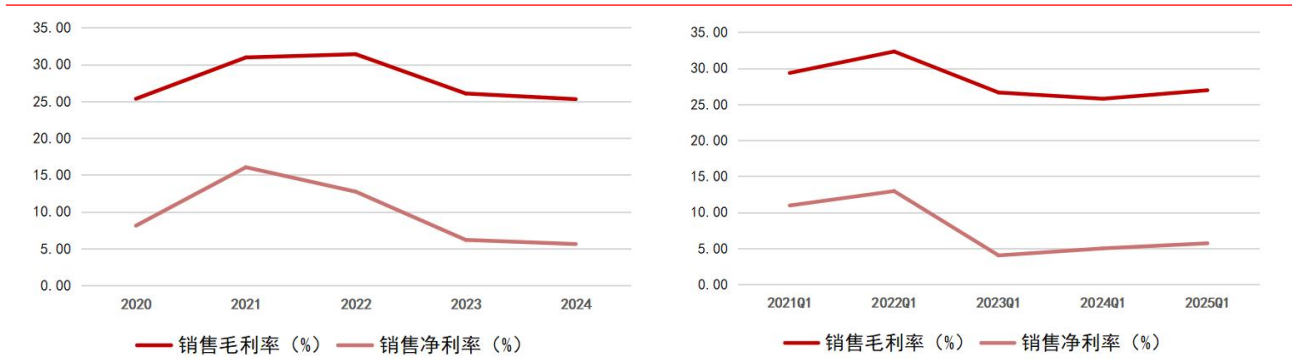


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

盈利能力：2024 年销售毛利率、净利率同比略有下降，2025 年一季度实现同比回升。盈利能力方面，半导体板块 2024 年销售毛利率和净利率分别为 25.30 和 5.62%，相比上年同期分别下降 0.77 个百分点和 0.56 个百分点，2025 年一季度（不含中芯、华虹）销售毛利率和净利率分别为 26.96%和 5.71%，相比上年同期分别提高 1.19 和 0.71 个百分点。

图 5：半导体板块 2020 年-2024 年毛利率、净利率（%） 图 6：半导体板块 2021Q1-2025Q1 毛利率、净利率（不含中芯、华虹）



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

综上所述，受益 AI 驱动需求复苏和关键领域国产替代持续推进，半导体行业自 2023 年下半年以来逐步进入景气复苏周期，并在 2024 年、2025 年一季度维持复苏态势，带动 2024 年、2025Q1 营收、归母净利润均实现同比正向增长。盈利能力方面，板块 2024 年盈利能力仍处于周期底部水平，销售毛利率、净利率相比 2023 年略有下滑，但行业自 2024 年下半年起盈利能力已逐步修复，并于 25Q1 实现同比正向增长。一季度为半导体行业传统淡季，但在算力类芯片供不应求、消费类芯片需求回暖以及设备、材料、零部件等环节自主可控加速推进等多方面因素加持下，半导体行业 2025 年一季度整体呈现“淡季不淡”特征，营收、净利润实现同比增长，且盈利能力有所提高。

2. 细分板块业绩情况

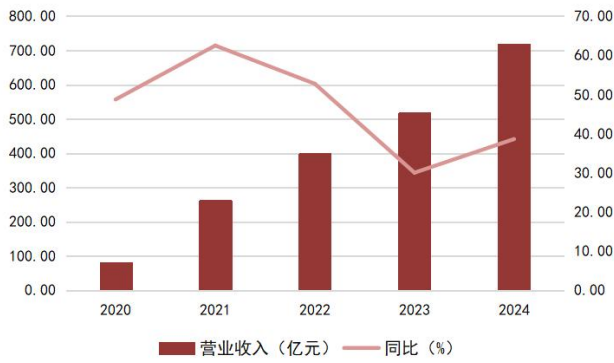
2.1 半导体设备：国产替代持续推进、营收、利润双双增长

选取申万半导体行业下的三级行业——“半导体设备”作为半导体设备代表，统计板块 2024 年全年和 2025 年第一季度业绩情况。

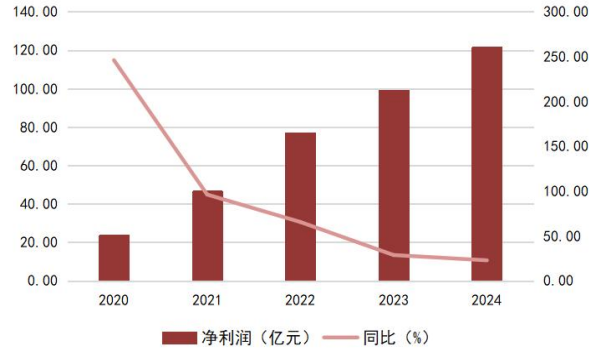
板块业绩：受益国产替代持续推进，半导体设备板块 2024 年、2025 年一季度经营业绩实现同比增长。 半导体设备板块 2024 年实现营收 718.45 亿元，同比+38.59%，实现归母净利润 121.76 亿元，同比+22.76%；板块 25Q1 实现营收 178.85 亿元，同比+33.38%，实现归母净利润 25.65 亿元，同比+24.12%。

图 7：半导体设备板块 2020 年-2024 年营收情况

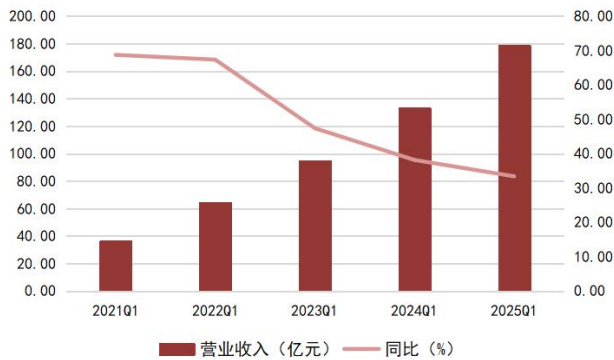
图 8：半导体设备板块 2020 年-2024 年归母净利润情况



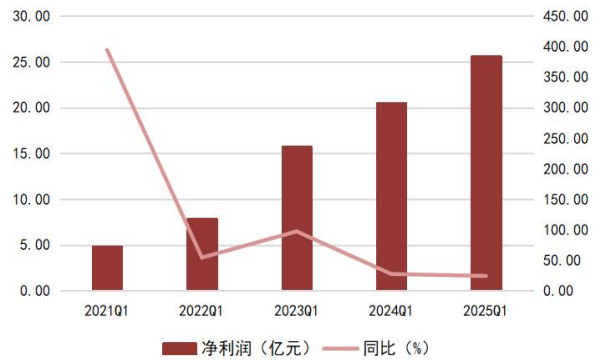
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所
图 9：半导体设备板块 2021Q1-2025Q1 营收情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所
图 10：半导体设备板块 2021Q1-2025Q1 归母净利润情况



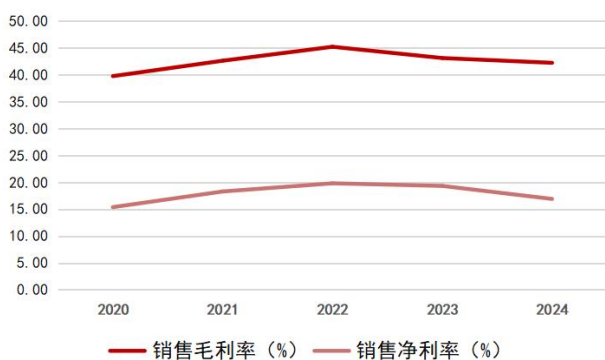
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所



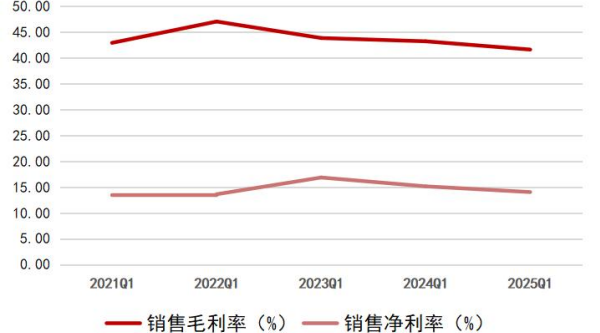
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

盈利能力：2024 年、2025 年一季度半导体设备板块盈利能力同比略有下滑。盈利能力方面，半导体设备板块 2024 年销售毛利率和净利率分别为 42.24%和 16.89%，相比上年同期分别下降 0.89 和 2.43 个百分点，板块 2025Q1 销售毛利率和净利率分别为 41.63%和 14.02%，相比上年同期分别下降 1.60 和 1.11 个百分点。

图 11：半导体设备板块 2020 年-2024 年毛利率、净利率图 图 12：半导体设备板块 2021Q1-2025Q1 毛利率、净利率 (%)



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

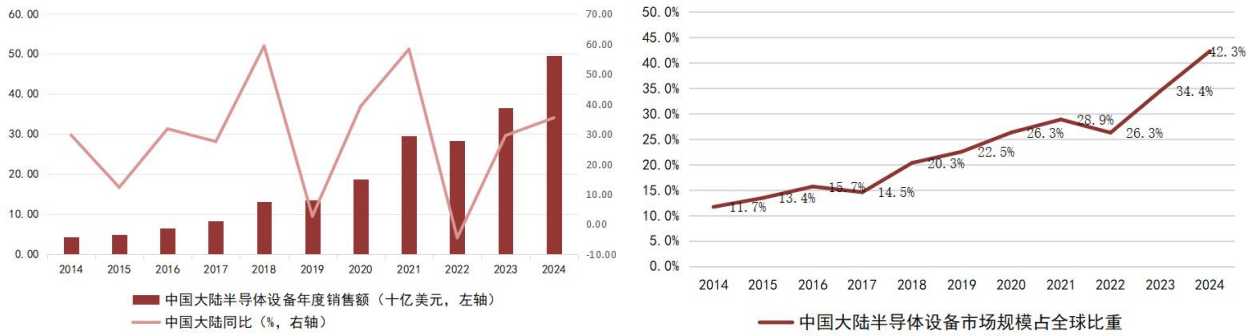


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

综上所述，受益国内 Fab 厂、OSAT 厂持续扩产，叠加各品类设备中标份额提高，半导体设备板块 2024 年、2025 年一季度营收、归母净利润实现同比增长，行业国产化进程持

续推进。盈利能力方面，2024 年、2025 年一季度半导体设备板块销售毛利率、净利率同比均有所下滑，但整体维持相对稳定。据日本半导体制造装置协会数据，中国大陆 2024 年半导体设备销售额为 495.4 亿美元，同比增长 35.37%，销售远高于全球平均水平，占全球比重也从 2015 年的 13.42% 提升至 42.29%，行业产值向中国大陆转移趋势明显。

图 13：中国大陆半导体设备年度销售金额及同比增长图 14：中国大陆半导体设备市场规模占全球比重率（2014-2024 年）



资料来源：日本半导体制造装置协会，东莞证券研究所

资料来源：日本半导体制造装置协会，东莞证券研究所

部分半导体设备企业业绩梳理

北方华创 (002371)：公司 2024 年实现营业收入 298.38 亿元，同比增长 35.14%，实现归母净利润 56.21 亿元，同比增长 44.17%，公司 2025 年一季度实现营收 82.06 亿元，同比增长 37.90%，实现归母净利润 15.81 亿元，同比增长 38.80%。受益下游逻辑代工大厂维持高资本开支扩产，叠加多品类设备国产替代持续推进，公司在手订单实现同比增长。3 月 10 日，北方华创公告称以现金为对价，协议受让先进制造持有的芯源微 9.49% 股份，合计 19,064,915 股，受让价格为 88.48 元/股，交易金额为 1,686,863,679.20 元。作为国内半导体设备龙头企业，北方华创在刻蚀、薄膜沉积、炉管、清洗等前道设备领域积累深厚，但在光刻领域的涂胶显影设备方面存在短板，而芯源微具备前道涂胶显影设备量产能力，产品覆盖 28nm 以上制程，且在化学清洗、先进封装湿法设备等方面有所布局。我们认为，本次并购有助于双方产品形成互补，可形成从前道制造到先进封装的全流程设备供应能力，尤其是在光刻机联机作业、3D 集成等领域形成战略呼应，增强企业长期竞争力。

中微公司 (688012)：公司 2024 年实现营业收入 90.65 亿元，同比增长 44.73%，实现归母净利润 16.16 亿元，同比下降 9.53%。公司 2024 年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约 13.88 亿元，较上年同期增加 16.51%。报告期内，公司各业务进展顺利，2024 年刻蚀设备销售约 72.77 亿元，同比增长约 54.72%；MOCVD 设备销售约 3.79 亿元，同比下降约 18.03%，LPCVD 设备 2024 年实现首台销售，全年设备销售约 1.56 亿元。公司 2024 年营收、扣非后净利润同比增长，但归母净利润同比下滑的主要原因为：2023 年公司出售了持有的部分拓荆科技股份有限公司股票，产生税后净收益约 4.06 亿元，而 2024 年公司并无该项股权处置收益。2024 年一季度，公司实现营收 21.73 亿元，同比增长 35.40%，实现归母净利润 3.13 亿元，同比增长 25.67%，主

营业务维持增长态势。

华海清科（688120）：公司 2024 年实现营收 34.06 亿元，同比增长 35.82%，实现归母净利润 10.23 亿元，同比增长 41.40%，公司 2025 年一季度实现营收 9.12 亿元，同比增长 34.14%，实现归母净利润 2.33 亿元，同比增长 15.47%。报告期内，公司凭借产品技术优势，成功把握市场机遇，CMP 产品市场占有率和销售规模持续提高，且公司持续加大研发投入和生产能力建设，增强企业核心竞争力，新产品研发和销售进展顺利，减薄装备、清洗装备、晶圆再生、CDS 和 SDS 等初显市场成效，提升了公司营收和盈利规模。

长川科技（300604）：公司 2024 年实现营收 36.42 亿元，同比增长 105.15%，实现归母净利润 4.58 亿元，同比增长 915.14%，公司 2025 年一季度实现营收 8.15 亿元，同比增长 45.74%，实现归母净利润 1.11 亿元，同比增长 2,623.82%。报告期内，公司继续加快测试设备研发进程，重点开拓了覆盖 SoC、逻辑等多种高端应用场景的数字测试设备、三温探针台、三温分选机、AOI 光学检测设备等相关封测设备，不断拓宽产品线并积极开拓中高端市场，带动营收、归母净利润实现同比增长。

2.2 半导体材料：25Q1 盈利回升，板块迎来业绩拐点

选取申万半导体行业下的三级行业——“半导体材料”作为半导体材料代表，统计板块 2024 年全年和 2025 年第一季度业绩情况。

板块业绩：半导体材料板块 2024 年净利润同比下滑，但 25Q1 出现利润拐点。半导体材料板块 2024 年实现营收 409.35 亿元，同比增长 12.46%，实现归母净利润 20.34 亿元，同比下降 23.90%；板块 25Q1 实现营收 104.13 亿元，同比增长 10.93%，实现归母净利润 6.72 亿元，同比增长 40.35%。

图 15：半导体材料板块 2020 年—2024 年营收情况

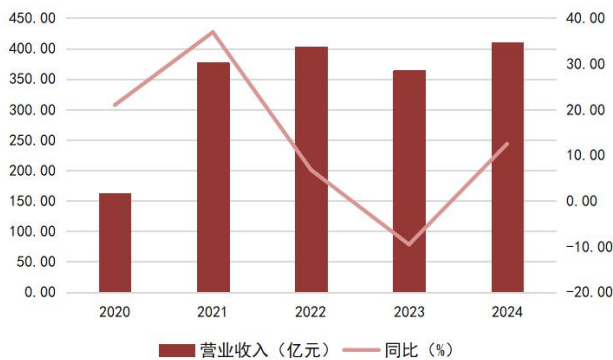
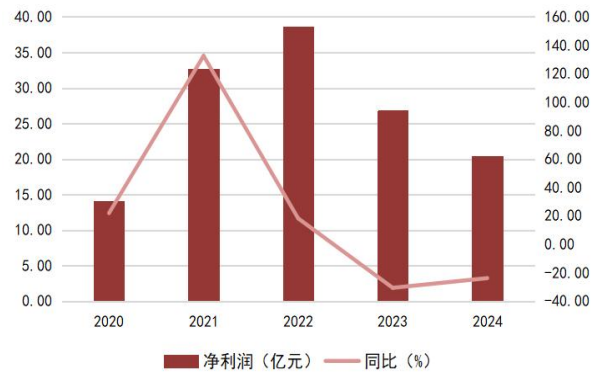


图 16：半导体材料板块 2020 年—2024 年归母净利润情况

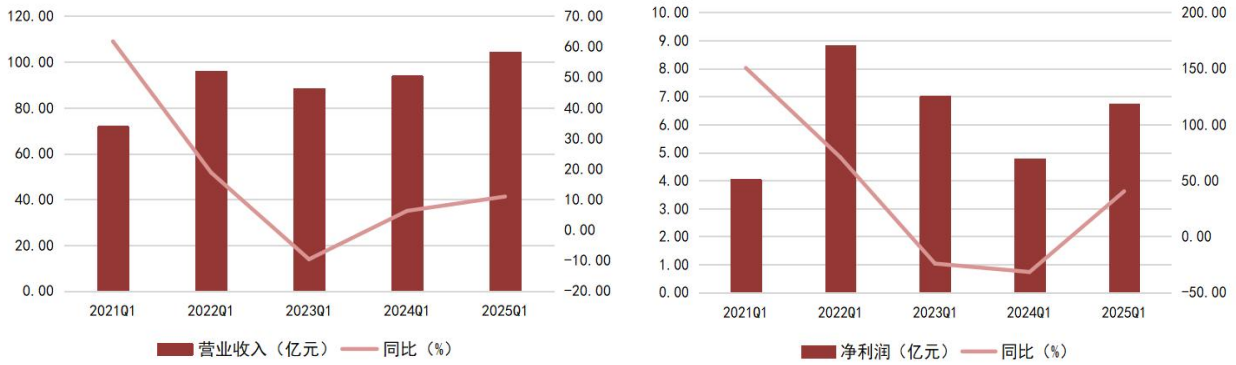


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 17：半导体材料板块 2021Q1-2025Q1 营收情况

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 18：半导体材料板块 2021Q1-2025Q1 归母净利润情况

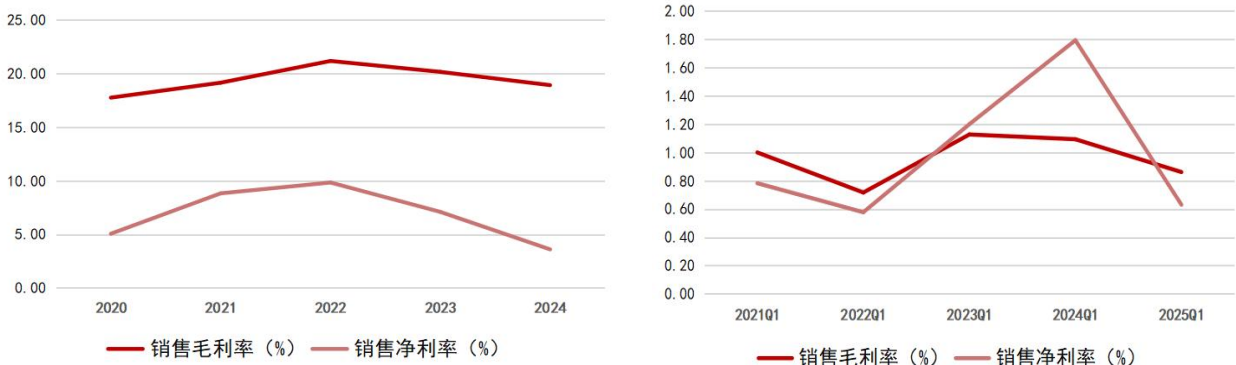


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

盈利能力：2024 年销售毛利率、净利率同比下滑，25Q1 实现同比回升。 盈利能力方面，半导体材料板块 2024 年销售毛利率和净利率分别为 18.93%和 3.60%，相比上年同期分别下降 1.24 和 3.50pct，板块 2025Q1 销售毛利率和净利率分别为 20.66%和 5.50%，相比上年同期分别提高 1.85pct 和 1.24pct。

图 19：半导体材料板块 2020 年—2024 年毛利率、净利率图 20：半导体材料板块 2021Q1-2025Q1 毛利率、净利率 (%)



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

受益半导体市场复苏以及高性能计算、高带宽内存制造对先进材料需求不断增长，2024 年半导体材料市场收入实现同比增长，据 SEMI 数据，2024 年全球半导体材料市场销售额为 675 亿美元，同比增长 3.8%。其中，晶圆制造材料全年收入增长 3.3%达到 429 亿美元，而封装材料收入同比增长 4.7%达到 246 亿美元。分地区来看，中国大陆 2024 年半导体材料录得收入 135 亿美元，同比增长 5.3%，销售额在全球所有地区中位列第二。大陆半导体材料企业在快速响应、生产成本方面具有一定优势，整体国产化率较低，伴随内资晶圆厂资本开支实现增长，2024 年营业收入实现同比增长，但以沪硅产业为代表的硅片大厂持续扩充 300mm 硅片产能拖累整体毛利率，影响板块利润表现；2024 年一季度，受益行业持续复苏，半导体材料板块迎来利润拐点，营收、归母净利润实现同比增长，且盈利能力有所回升。

图 21：2024 年全球半导体材料收入情况（按地区，金额单位：百万美元）

Region	2024	2023	YoY % Growth
Taiwan	\$20,090	\$18,734	7.2%
China	\$13,458	\$12,779	5.3%
South Korea	\$10,451	\$10,368	0.8%
Rest of World	\$7,039	\$6,545	7.5%
Japan	\$6,524	\$6,740	-3.2%
North America	\$5,539	\$5,529	0.2%
Europe	\$4,368	\$4,298	1.6%
Total	\$67,468	\$64,994	3.8%

数据来源：SEMI，东莞证券研究所

部分半导体材料企业业绩梳理

江丰电子（300666）：公司 2024 年实现营收 36.05 亿元，同比增长 38.57%，实现归母净利润 4.01 亿元，同比增长 56.79%，公司 2025 年一季度实现营收 10.00 亿元，同比增长 29.53%，实现归母净利润 1.57 亿元，同比增长 163.58%。报告期内，公司靶材业务进展顺利，2024 年靶材业务收入为 23.33 亿元，同比增长 39.5%，在技术、市场份额均跻身全球领先水平；半导体零部件业务方面，公司 2024 年半导体零部件业务实现营收 8.87 亿元，同比增长 55.53%，营收占比为 24.6%，成为公司业绩的第二增长点。2025 年一季度，公司主营业务维持同比增长态势，且转让联营企业上海润平部分股权也进一步抬高公司归母净利润增速。

鼎龙股份（300054）：公司 2024 年实现营收 33.38 亿元，同比增长 25.14%，实现归母净利润 6.39 亿元，同比增长 122.00%，公司 2025 年一季度实现营收 8.24 亿元，同比增长 16.37%，实现归母净利润 1.41 亿元，同比增长 72.84%。2024 年，公司加大对 CMP 抛光液、高端晶圆光刻胶、半导体先进封装材料、新领域芯片等业务领域的研发投入，全年研发投入为 4.62 亿元，同比增长 21.01%，占营收比重达 13.84%。受益研发驱动公司业务发展，公司 2024 年、2025 年一季度各产品销售情况顺利，其中 CMP 抛光垫 2024 年收入达 7.16 亿元，同比增长 71.51%，CMP 抛光液与清洗液收入为 2.15 亿元，同比增长 178.89%。

雅克科技（002409）：公司 2024 年实现营收 68.62 亿元，同比增长 44.84%，实现归母净利润 8.72 亿元，同比增长 50.41%。公司 2025 年一季度实现营收 21.18 亿元，同比增长 30.88%，实现归母净利润 2.60 亿元，同比增长 5.85%。报告期内，公司继续深耕电子材料、液化天然气（LNG）保温绝热板材以及阻燃剂三大产品领域，其中前驱体业务已实现了 12 寸晶圆客户端全覆盖，显示面板用光刻胶已进入京东方、华星光电、LG Display 等头部显示面板制造企业供应链，产品质量和技术继续保持业内领先地位。

2.3 数字芯片设计：AI 拉动算力增长，“国补”释放消费需求

选取申万半导体行业下的三级行业——“数字芯片设计”作为数字芯片设计板块代表，统计板块 2024 年全年和 2025 年第一季度业绩情况。

板块业绩：板块 2024 年、2025 年一季度营收、归母净利润均实现同比增长。数字芯片设计板块 2024 年实现营收 1,492.01 亿元，同比+28.17%，实现归母净利润 135.96 亿元，同比+213.62%；板块 25Q1 实现营收 379.66 亿元，同比+20.27%，实现归母净利润 32.56 亿元，同比+20.59%。

图 22：数字芯片设计板块 2020 年—2024 年营收情况

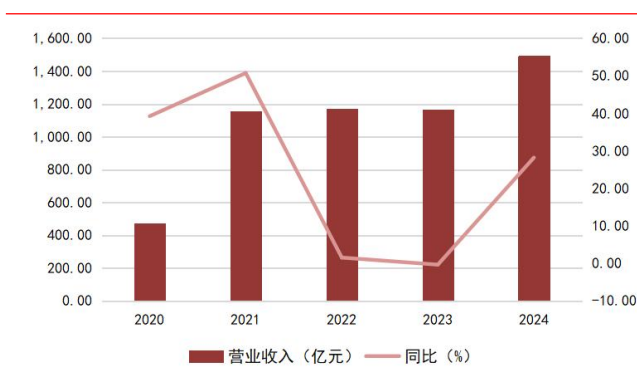
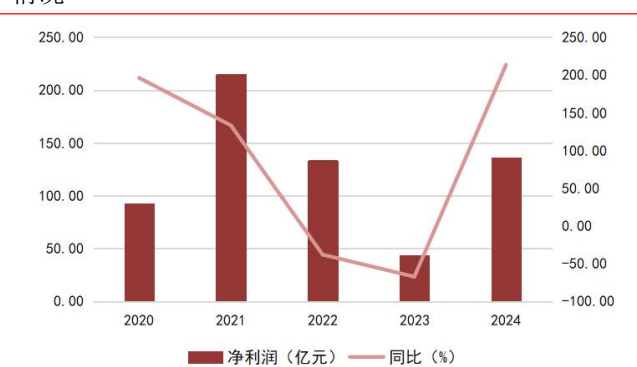


图 23：数字芯片设计板块 2020 年—2024 年归母净利润情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 24：数字芯片设计板块 2021Q1-2025Q1 营收情况

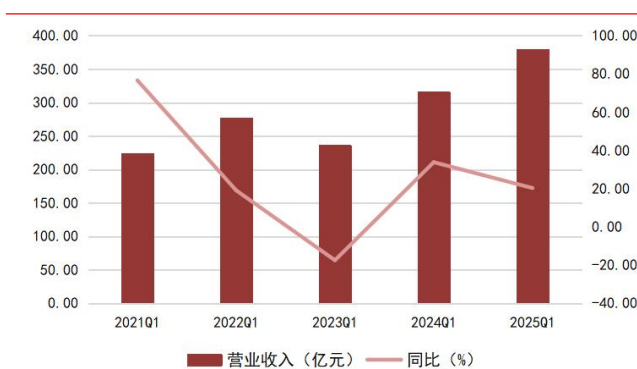
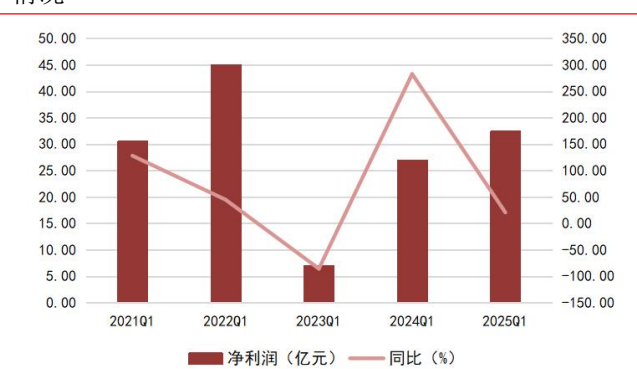


图 25：数字芯片设计板块 2021Q1-2025Q1 归母净利润情况



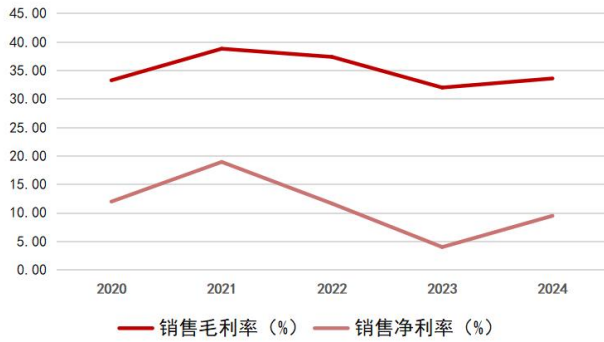
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

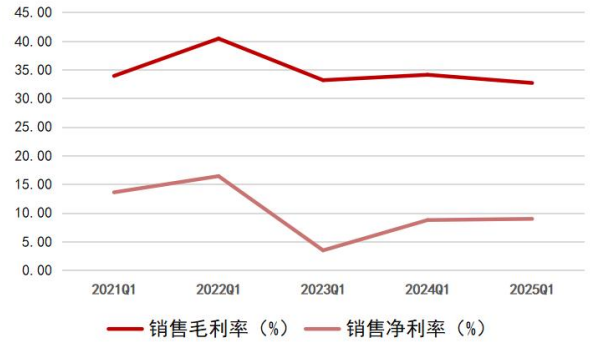
盈利能力：2024 年盈利能力同比提高，2025 年一季度销售毛利率有所下降。盈利能力方面，数字芯片设计板块 2024 年销售毛利率和净利率分别为 33.57%和 9.47%，相比上年同期分别提高 1.60 和 5.49pct，2025Q1 销售毛利率和净利率分别为 32.68%和 8.96%，相比上年同期分别下降 1.43 个百分点、提升 0.21 个百分点。

图 26：数字芯片设计板块 2020 年—2024 年毛利率、净利率 (%)

图 27：数字芯片设计板块 2021Q1-2025Q1 毛利率、净利率 (%)



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

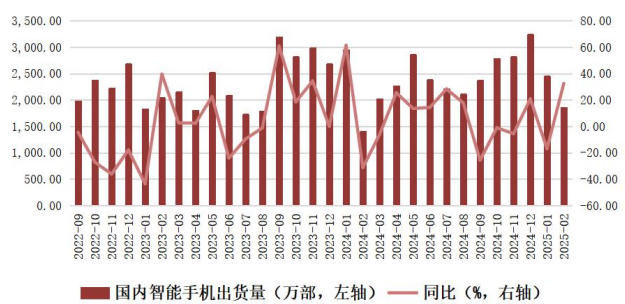
2024 年，AI 上游算力需求持续紧张，“国补”落地驱动智能手机、PC 等终端需求回暖，叠加 AI 眼镜、AR/VR 等智能终端渗透率持续提升，带动数字芯片设计板块营收、净利润实现同比增长。智能手机方面，2024 年全球智能手机出货量为 12.23 亿台，同比增长 5.23%（IDC 数据），国内智能手机出货量为 2.94 亿台，同比增长 6.48%（工信部数据）；AI 眼镜方面，据佰维存储 2024 年年报数据，2024 年全球 AI 眼镜市场迎来爆发式增长，出货量达到 152 万台，同比增长 533%。根据 IDC 预计，2025 年全球包含 AI 眼镜、AR/VR 眼镜等在内的智能眼镜市场出货量为 1,205 万台，同比增长 18.3%；其中不具备显示功能的音频眼镜及音频拍摄眼镜预计出货 547 万台，同比增长 101.9%。展望 2025 年全年，上游 AI 算力、下游智能终端的旺盛需求有望助推数字芯片设计板块业绩实现持续增长。

图 28：全球智能手机季度出货量



资料来源：IDC，东莞证券研究所

图 29：国内智能手机月度出货情况



资料来源：工信部，东莞证券研究所

部分数字芯片设计企业业绩梳理

韦尔股份 (603501)：公司 2024 年实现营收 257.31 亿元，同比增长 22.41%，实现归母净利润 33.23 亿元，同比增长 498.11%；公司 2025 年一季度实现营收 64.72 亿元，同比增长 14.68%，实现归母净利润 8.66 亿元，同比增长 55.25%。报告期内，公司积极推进产品结构优化，产品向高端化方向进展顺利。智能手机方面，公司所推出的 1.2um 5,000 万像素高端图像传感器 OV50H，凭借其优异的性能被广泛应用于国内主流高端智能手机后置主摄方案中，伴随着产能顺利爬坡，公司在高端智能手机领域市场份额持续提升。2024 年，公司图像传感器业务来源于智能手机市场的收入约 98.02 亿元，较上年同期

增加 26.01%；车载业务方面，公司凭借先进紧凑的汽车 CIS 解决方案已经覆盖了 ADAS、驾驶室内部监控、电子后视镜、仪表盘摄像头、后视和全景影像等广泛的汽车应用，产品表现出的优秀性能也帮助公司导入更多新的设计方案。2024 年，公司图像传感器业务来源于汽车市场的收入实现约 59.05 亿元，较上年同期增加 29.85%，市场份额持续提升。

思特威（688213）：公司 2024 年实现营收 59.68 亿元，同比增长 108.87%，实现归母净利润 3.93 亿元，同比增长 2,662.76%，公司 2025 年一季度实现营收 17.50 亿元，同比增长 108.94%，实现归母净利润 1.91 亿元，同比增长 1,264.97%，2024 年，2025 年一季度归母净利润均实现同比大幅增长。2024 年，公司各项业务进展顺利，在全球安防 CIS 中出货排名蝉联第一位，市场份额达到 48.2%，车载 CIS 出货排名位列第四位，国内排名第 2 位；全球手机 CIS 市场出货排名位列第 5 位，出货份额占比达到 11.2%；2025 年一季度，公司在智能手机与高端车载市场客户市占率继续提高，经营业绩维持高速增长态势，单季度营收、归母净利润均创历史同期新高。

澜起科技（688008）：公司 2024 年实现营收 36.39 亿元，同比增长 59.20%，实现归母净利润 14.12 亿元，同比增长 213.10%；公司 2025 年一季度实现营收 12.22 亿元，同比增长 65.78%，实现归母净利润 5.25 亿元，同比增长 135.14%。2024 年，全球服务器及计算机需求回暖，公司把握行业复苏机遇，持续加大技术创新和市场拓展，带动经营业绩实现显著增长。内存接口芯片方面，公司内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长，同时受益于 DDR5 下游渗透率提升且子代持续迭代，公司 DDR5 内存接口芯片出货量超过 DDR4 内存接口芯片，DDR5 第二子代内存接口芯片出货量超过第一子代产品；另一方面，受益于 AI 产业趋势推动，公司三款高性能运力芯片新产品（PCIe Retimer、MRCD/MDB 及 CKD）开始规模出货，其中：PCIe Retimer 芯片在下游实现规模应用，MRCD/MDB 芯片及 CKD 芯片开始在行业规模试用，三款新产品合计销售收入约为 4.22 亿元，是上年度的 8 倍，为公司贡献新的业绩增长点。分业务来看，公司互连类芯片产品线实现销售收入 33.49 亿元，较上年度增长 53.31%，毛利率为 62.66%，较上年度提升 1.30 个百分点；津逮服务器平台产品线实现销售收入 2.80 亿元，较上年度增长 198.87%。

佰维存储（688525）：公司 2024 年实现营收 66.95 亿元，同比增长 86.46%，实现归母净利润 1.35 亿元，同比增长 121.44%；公司 2024 年一季度实现营收 15.43 亿元，同比下降 10.62%，实现归母净利润-1.97 亿元，同比下降 217.87%。受全球宏观经济影响，存储价格从 24Q3 开始逐季下滑，25Q1 达到阶段性低点，公司产品销售价格降幅较大，导致 25Q1 营业收入同比下滑 10.62%，销售毛利率同比下降 22.75 个百分点；随着存储价格从 2025 年第二季度开始企稳回升，公司经营业绩有望逐步改善；此外，受客户项目节奏影响，第一季度公司面向 AI 眼镜、AI 手机等领域的高价值产品销售金额较低，随着上述产品从第二季度开始批量交付，公司的营业收入和毛利率有望进一步回升。公司在业绩交流会上表示，2024 年公司面向 AI 眼镜产品收入约 1.06 亿元，预计 2025 年公司面向 AI 眼镜产品收入有望同比增长超过 500%。

兆易创新（603986）：公司 2024 年实现营收 73.56 亿元，同比增长 27.69%，实现归母净利润 11.03 亿元，同比增长 584.21%；公司 2025 年一季度实现营收 19.09 亿元，同比

增长 17.32%，实现归母净利润 2.35 亿元，同比增长 14.57%。2024 年，公司继续保持以市场占有率为中心的策略，持续进行研发投入和产品迭代，不断优化产品成本并丰富产品矩阵，在消费、网通、计算等多个领域均实现收入、销量同比增长。2025 年一季度，受益国家一揽子政策刺激终端电子产品需求，以及 AI 手机、AI PC 带动存储容量需求提升，公司经营业绩保持正向增长。

乐鑫科技（688018）：公司 2024 年实现营收 20.07 亿元，同比增长 40.04%，实现归母净利润 3.39 亿元，同比增长 149.13%；公司 2025 年一季度实现营收 5.58 亿元，同比增长 44.08%，实现归母净利润 0.94 亿元，同比增长 73.80%。公司在 Wi-Fi MCU 市场占据领先地位，通过高性能、低功耗的 ESP32 系列芯片和多协议支持（Wi-Fi、蓝牙）的技术优势，满足了不同应用场景的需求，巩固其市场地位；此外，公司积极拓展 AIoT SoC 业务，提供从芯片设计到软件开发、云服务的全栈解决方案。公司推出的 ESP RainMaker 平台，集成了设备管理、远程控制、数据分析等功能，简化了物联网设备的开发和管理流程，展示了其在 AIoT 领域的强大竞争力。

海光信息（688041）：公司 2024 年实现营收 91.62 亿元，同比增长 52.40%，实现归母净利润 19.31 亿元，同比增长 52.87%；公司 2025 年一季度实现营收 24.00 亿元，同比增长 50.76%，实现归母净利润 5.06 亿元，同比增长 75.33%。2024 年和 2025 年一季度，公司整体经营情况持续向好，尤其是在高端处理器产品的产业生态版图不断拓展，涉及的行业应用以及新兴人工智能大模型产业逐步增加。分产品来看，公司 CPU 产品已支持了广泛的数据中心、云计算、高端计算等复杂应用场景，市场份额逐步提高；DCU 产品则以高算力、高并行处理能力、良好的软件生态支持了算力基础设施、商业计算等行业应用。

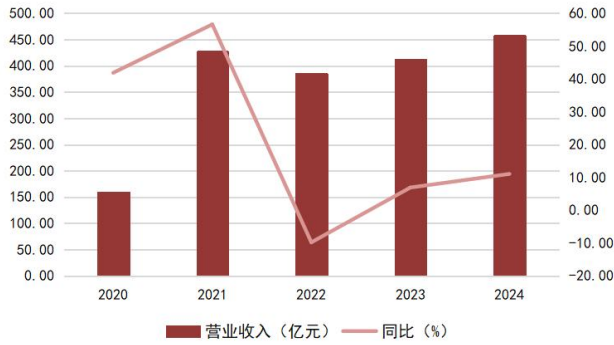
2.4 模拟芯片设计：工控、汽车开始复苏，龙头企业结构优化

选取申万半导体行业下的三级行业——“模拟芯片设计”作为模拟芯片设计代表，统计板块 2024 年全年和 2025 年第一季度业绩情况。

板块业绩：2024 年利润端为负，2025Q1 净利润实现同比大幅增长。模拟芯片设计板块 2024 年实现营收 457.33 亿元，同比+11.03%，实现归母净利润-1.19 亿元，同比-130.29%；板块 25Q1 实现营收 109.20 亿元，同比+8.01%，实现归母净利润 0.83 亿元，同比+172.61%。

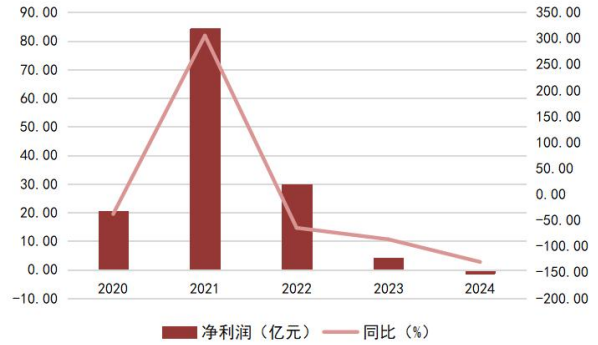
图 30：模拟芯片设计板块 2020 年—2024 年营收情况

图 31：模拟芯片设计板块 2020 年—2024 年归母净利润情况



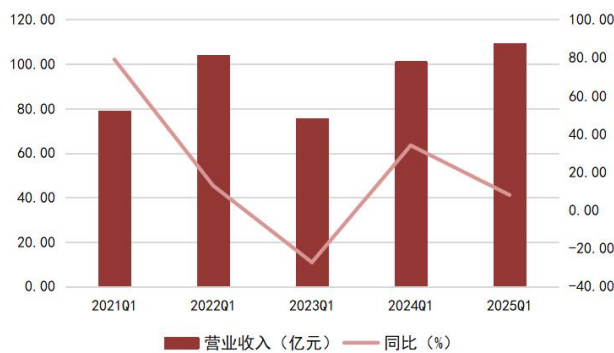
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 32：模拟芯片设计板块 2021Q1-2025Q1 营收情况

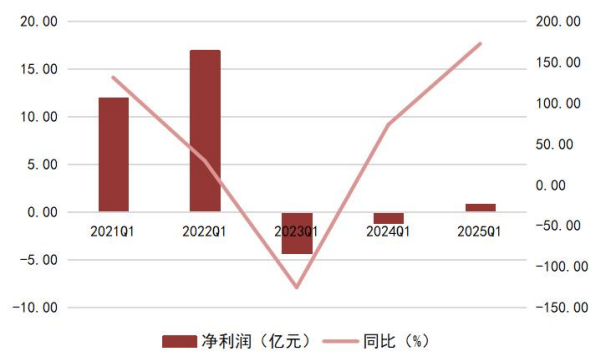


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 33：模拟芯片设计板块 2021Q1-2025Q1 归母净利润情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

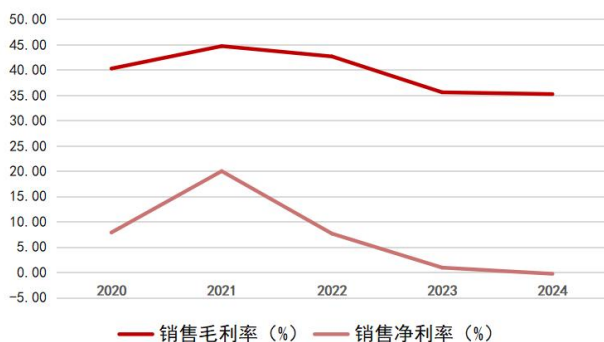


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

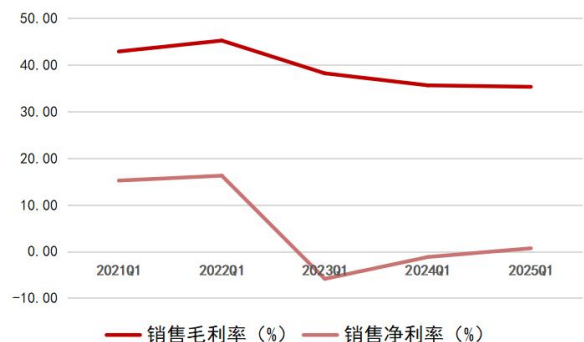
盈利能力：2025 年一季度销售净利率实现同比增长。盈利能力方面，模拟芯片设计板块 2024 年销售毛利率和净利率分别为 35.21%和-0.32%，相比上年同期分别下降 0.35 个百分点和 1.22 个百分点，2025Q1 销售毛利率和净利率分别为 35.32%和 0.68%，相比上年同期分别下降 0.31 个百分点、提升 1.87 个百分点。

图 34：模拟芯片设计板块 2020 年一 2024 年毛利率、净利率图

图 35：模拟芯片设计 2021Q1-2025Q1 毛利率、净利率率 (%)



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

综上所述，2024 年全球模拟芯片行业呈现“U”型特征，全年整体业绩承压，尤其是工业、汽车等细分市场需求疲软，行业去库存缓慢。虽然板块全年营收实现同比增长，但归母净利润同比大幅下滑。进入 2024 年下半年以来，以消费电子为代表的细分市场开始回暖，且汽车、通信、工业需求开始恢复，行业景气度开始回升。此外，国内模拟芯

片上市企业开始向汽车、工业等高附加值领域拓展业务，带动板块 25Q1 经营业绩、销售净利率实现同比提高。

部分模拟芯片设计企业业绩梳理

圣邦股份（300661）：公司 2024 年实现营收 33.47 亿元，同比增长 27.96%，实现归母净利润 5.00 亿元，同比增长 78.17%；公司 2025 年一季度实现营收 7.90 亿元，同比增长 8.30%，实现归母净利润 0.60 亿元，同比增长 9.90%。2024 年，公司产品结构有所优化，高端化产品占比提高，带动归母净利润增速显著高于营收增速；研发投入方面，公司 2024 年研发费用支出 8.71 亿元，占营收比重 26.02%，研发人员 1,184 人，占公司员工总数 74.09%，研发投入、研发人员数量逐年增加。2025 年一季度，公司经营业绩保持平稳增长，单季度销售毛利率为 49.07%，受行业季节性影响环比略有下滑，但仍高于行业均值，经营韧性凸显。

思瑞浦（688536）：公司 2024 年实现营收 12.20 亿元，同比增长 11.52%，实现归母净利润-1.97 亿元，同比下降 468.13%；公司 2025 年一季度实现营收 4.22 亿元，同比增长 110.88%，实现归母净利润 0.16 亿元，同比增长 131.65%。2024 年，受产品结构变动及市场竞争等因素影响，公司产品价格和毛利率阶段性承压，此外期间研发、销售费用增加，以及公司计提存货跌价准备等因素导致全年归母净利润为负；2025 年一季度，下游汽车、泛工业、泛通信等领域需求恢复，公司经营业绩迎来拐点，营收、净利润实现同比、环比增长。

艾为电子（688798）：公司 2024 年实现营收 29.33 亿元，同比增长 15.88%，实现归母净利润 2.55 亿元，同比增长 399.68%；公司 2025 年一季度实现营收 6.40 亿元，同比下降 17.50%，实现归母净利润 0.64 亿元，同比增长 78.86%。报告期内，公司对高性能数模混合信号、电源管理、信号链三大类产品持续进行产品创新，持续开拓消费电子、工业互联、汽车市场领域。截至 2024 年底，公司累计发布产品 1,400 余款，产品子类达到 42 类，年出货量超 60 亿颗，营收及产品出货量创历史新高；2025 年一季度，随着新产品持续放量及工业互联、汽车领域的持续开拓，公司综合毛利率较上年同期增长 7.82 个百分点，且毛利额有所提升；公司 2025 年一季度毛利率为 35.06%，盈利能力持续提升。

2.5 半导体封测：龙头企业经营稳健，全年营收逐季改善

选取申万半导体行业下的三级行业——“集成电路封测”作为半导体封测代表，统计板块 2024 年全年和 2025 年第一季度业绩情况。

板块业绩：板块 2024 年、2025 年一季度营收、归母净利润实现同比增长。半导体封测板块 2024 年实现营收 860.62 亿元，同比+18.43%，实现归母净利润 36.84 亿元，同比+35.37%；板块 25Q1 实现营收 218.97 亿元，同比+24.02%，实现归母净利润 4.31 亿元，

同比+8.12%。

图 36: 半导体封测板块 2020 年—2024 年营收情况

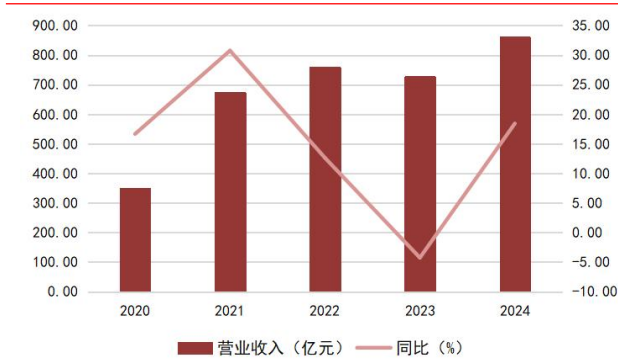
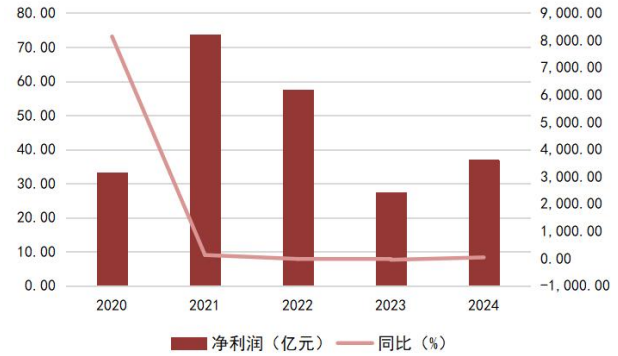


图 37: 半导体封测板块 2020 年—2024 年归母净利润情况



资料来源: 同花顺 iFind, 东莞证券研究所

资料来源: 同花顺 iFind, 东莞证券研究所

图 38: 半导体封测板块 2021Q1-2025Q1 营收情况

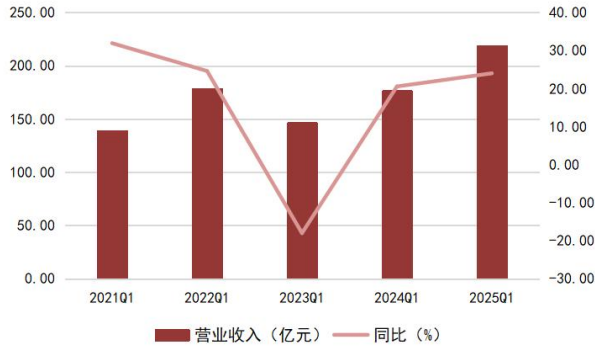
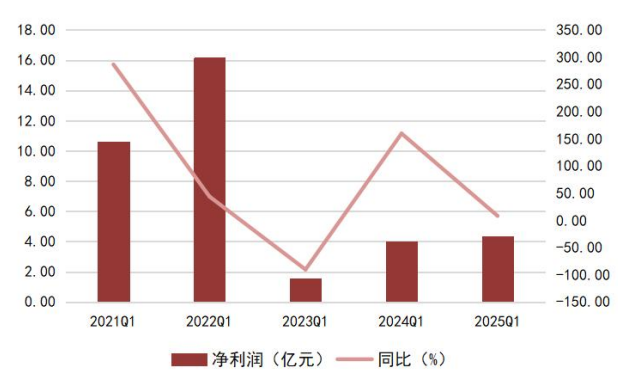


图 39: 半导体封测板块 2021Q1-2025Q1 归母净利润情况



资料来源: 同花顺 iFind, 东莞证券研究所

资料来源: 同花顺 iFind, 东莞证券研究所

盈利能力: 2024 年毛利率、净利率同比提升, 25Q1 净利率略有下滑。 盈利能力方面, 半导体封测板块 2024 年销售毛利率和净利率分别为 14.75%和 4.44%, 相比上年同期分别提高 1.06pct 和 0.60pct, 2025Q1 销售毛利率和净利率分别为 13.25%和 1.93%, 相比上年同期分别变动: +0.41pct, -0.35pct。

图 40: 半导体封测板块 2020 年—2024 年毛利率、净利率图

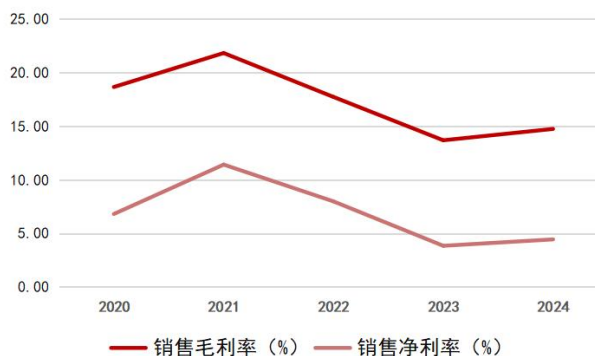
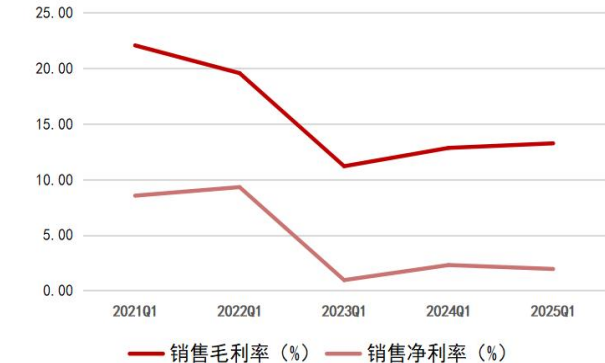


图 41: 半导体封测板块 2021Q1-2025Q1 毛利率、净利率

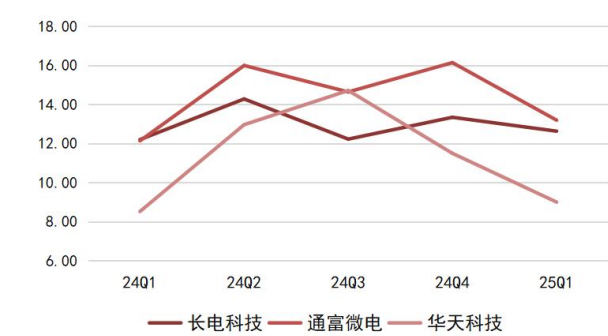
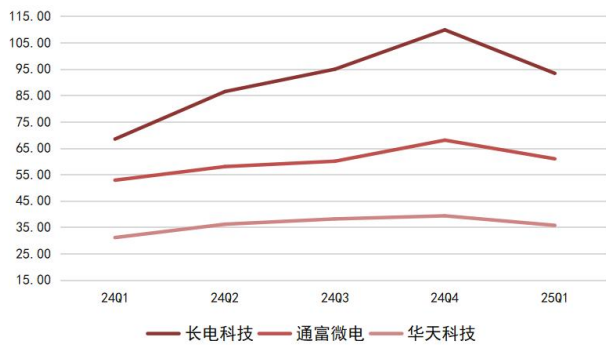


资料来源: 同花顺 iFind, 东莞证券研究所

资料来源: 同花顺 iFind, 东莞证券研究所

综上所述，半导体封测板块 2024 年、2025 年一季度营收、归母净利润实现同比增长，且盈利能力维持相对稳定。选取长电科技、通富微电、华天科技三家封测龙头企业进行分析，三家企业 2024 年营收均呈逐季改善态势，且 25Q1 营收均实现同比正向增长；盈利能力方面，三家企业 2024 年以来单季度销售毛利率维持稳定，且 25Q1 毛利率相比上年同期均实现提升，表明行业整体经营态势良好。

图 42：部分半导体封测企业 2024Q1-2025Q1 营收（亿元）图 43：部分半导体封测企业 2024Q1-2025Q1 销售毛利率（%）



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

部分半导体封测企业业绩梳理

长电科技（600584）：公司 2024 年实现营收 359.62 亿元，同比增长 21.24%，实现归母净利润 16.10 亿元，同比增长 9.44%，公司 2025 年一季度实现营收 93.35 亿元，同比增长 36.44%，实现归母净利润 2.03 亿元，同比增长 50.39%。2024 年，受益人工智能驱动、智能手机回暖和下游晶圆厂持续扩产，全球半导体行业持续回暖。作为全球封测龙头企业，公司在报告期内持续聚焦尖端技术和重点应用市场与客户，深耕通讯、消费、运算和汽车电子四大核心应用领域，通过优化产品结构、提升产能利用率、加强成本控制等措施保持了盈利能力的稳定，2024 年营收创历史新高；2025 年一季度，国内外先进封装市场订单维持增长，叠加晟碟半导体（上海）有限公司财务并表影响，带动公司营收实现同比增长。

通富微电（002156）：公司 2024 年实现营收 238.82 亿元，同比增长 7.24%，实现归母净利润 6.78 亿元，同比增长 299.90%。公司 2025 年一季度实现营收 60.92 亿元，同比增长 15.34%，实现归母净利润 1.01 亿元，同比增长 2.94%。2024 年，全球半导体行业逐步进入上行周期，公司积极调整产能布局，苏州工厂与槟城工厂不断强化与国际大客户等行业领先企业的深度合作，进一步扩大先进产品市占率，在品质提升、技术研发、新工厂建设、营运及人才融合等方面收获良好的效益；2025 年一季度，公司维持良好经营态势，营收、净利润均实现同比增长，且营收创历史同期新高。

2.6 分立器件：下游需求弱势复苏，25Q1 利润回升

选取申万半导体行业下的三级行业——“分立器件”作为分立器件板块代表，统计板块 2024 年全年和 2025 年第一季度业绩情况。

板块业绩：分立器件板块 25Q1 营收同比下滑，但归母净利润实现同比增长。分立器件板块 2024 年实现营收 1,080.95 亿元，同比+17.22%，实现归母净利润-3.32 亿元，同比-107.36%；板块 25Q1 实现营收 219.91 亿元，同比-6.86%，实现归母净利润 8.84 亿元，同比+27.37%。

图 44：分立器件板块 2020 年—2024 年营收情况

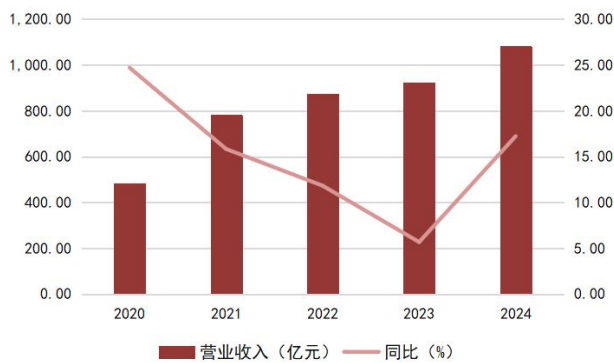
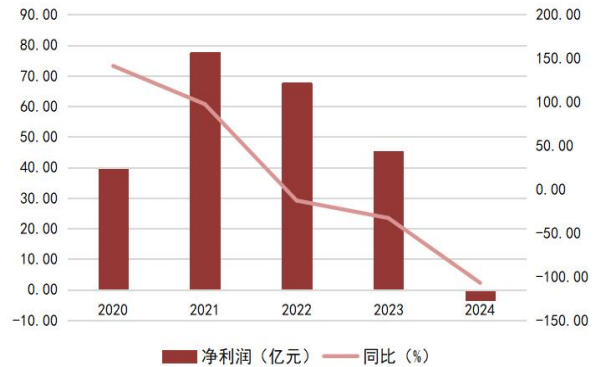


图 45：分立器件板块 2020 年—2024 年归母净利润情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 46：分立器件板块 2021Q1-2025Q1 营收情况

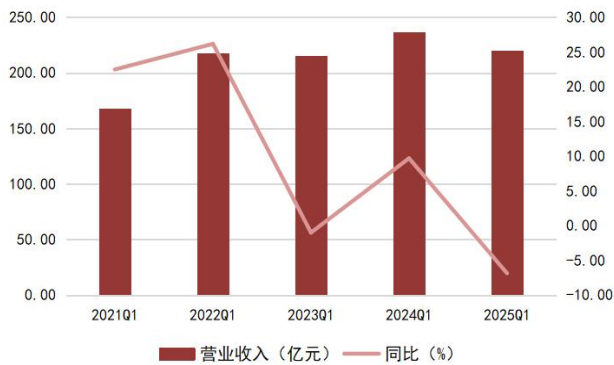
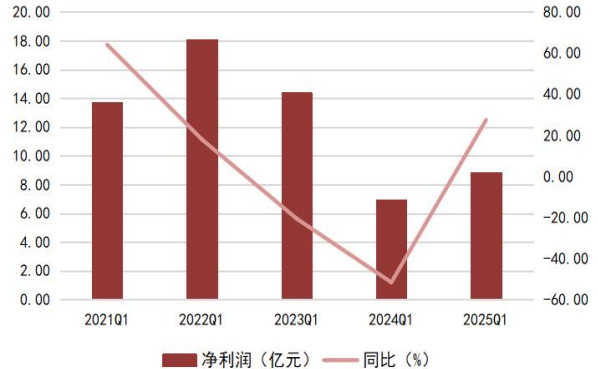


图 47：分立器件板块 2021Q1-2025Q1 归母净利润情况

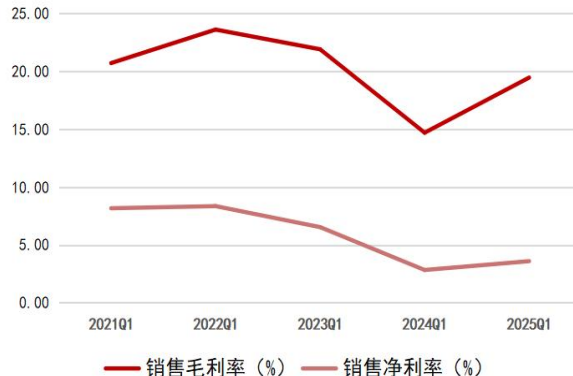
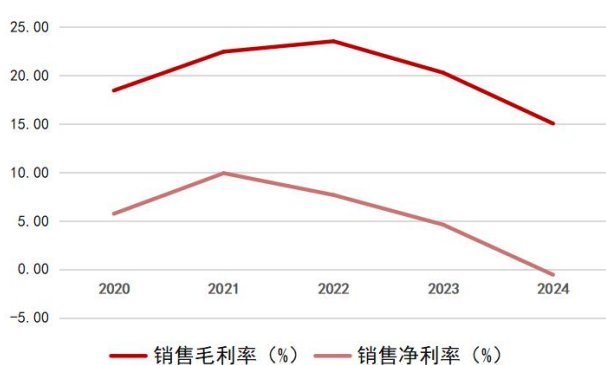


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

盈利能力：2024 年板块盈利能力承压，2025Q1 有所回升。盈利能力方面，分立器件板块 2024 年销售毛利率和净利率分别为 15.04%和-0.58%，相比上年同期分别下降 5.25pct 和 5.17pct，板块盈利能力整体承压；板块 2025Q1 销售毛利率和净利率分别为 19.46%和 3.58%，相比上年同期分别提高 4.77pct 和 0.76pct，盈利能力有所回升。

图 48：分立器件板块 2020 年—2024 年毛利率、净利率(%)图 49：分立器件板块 2021Q1-2025Q1 毛利率、净利率



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

综上所述，受全球纯电车销售增长放缓等影响，2024 年功率半导体市场景气低迷，行业去库存进展缓慢，海外英飞凌、瑞萨、Wolf speed 等大厂均通过削减员工数量来收缩产能。进入 2025 年一季度，受益国补政策提振消费需求，叠加汽车芯片等高附加值领域国产化率持续提高，行业库存实现缓慢去化，部分功率半导体价格得以修复，分立器件板块经营业绩呈现小幅复苏，板块净利润同比回暖，且毛利率、净利率相比上年同期有所提高。

部分分立器件企业业绩梳理

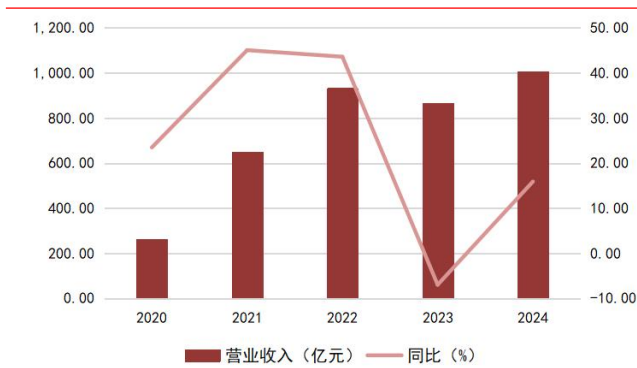
扬杰科技 (300373)：公司 2024 年实现营收 60.33 亿元，同比增长 11.53%，实现归母净利润 10.02 亿元，同比增长 8.50%；公司 2025 年一季度实现营收 15.79 亿元，同比增长 18.90%，实现归母净利润 2.73 亿元，同比增长 51.22%。2024 年，公司不断加大 Mosfet、IGBT、SiC 等产品在新能源汽车、人工智能、工业、光伏储能等市场的推广力度，整体订单和出货量较 2023 年实现提升；2025 年一季度，公司持续加大高附加值新产品的研发投入力度，新产品在高端应用场景持续导入上量，带来营收和利润率的双提高，分业务来看，2025 年第一季度公司汽车电子业务营收较上年同期增长超 70%，消费电子领域营收较上年同期增长超 27%，客户布局规模化效应持续显现。

士兰微 (300373)：公司 2024 年实现营收 112.21 亿元，同比增长 20.14%，实现归母净利润 2.20 亿元，同比增长 714.40%，实现扣非后归母净利润 2.52 亿元，同比增长 327.34%；公司 2025 年一季度实现营收 30.00 亿元，同比增长 21.70%，实现归母净利润 1.49 亿元，同比增长 1,072.43%，实现扣非后归母净利润 1.45 亿元，同比增长 8.96%。2024 年，公司电源管理芯片取得较大进展，在汽车、大型白电、服务器、高端消费电子等领域推出了一批新产品，应用于服务器的 DrMOS 电路和 Efuse 电路、应用于汽车的带功能安全的电源管理电路和低压预驱电路，以及创新的高性能快充电路等都已在客户端测试或已量产；32 位 MCU 电路产品方面，2024 年该产品维持较快增长态势，其营业收入较上年同期增长约 36%。

2.7 集成电路制造：成本上升拖累利润端表现，大力扩产助力长期增长

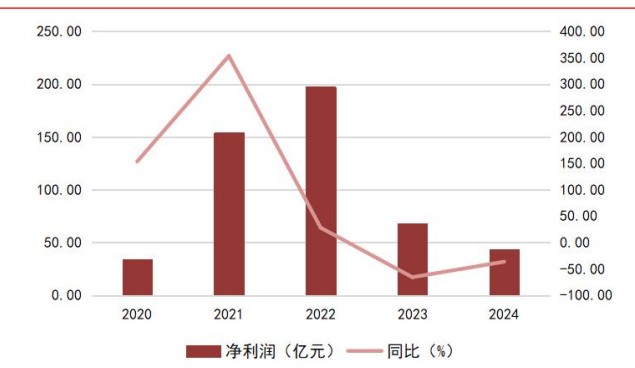
板块业绩：2024 年营业收入实现正向增长，但利润端同比下滑。集成电路制造板块选取申万半导体行业下的三级行业——“集成电路制造”作为集成电路制造板块代表。截至 5 月 7 日，该板块共有 7 家上市企业，其中中芯国际、华虹半导体两家企业尚未披露 2025 年一季度业绩。集成电路制造板块 2024 年实现营业收入 1,003.55 亿元，同比增长 15.89%，实现归母净利润 43.03 亿元，同比下降 36.39%。

图 50：集成电路制造板块 2020 年—2024 年营收情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

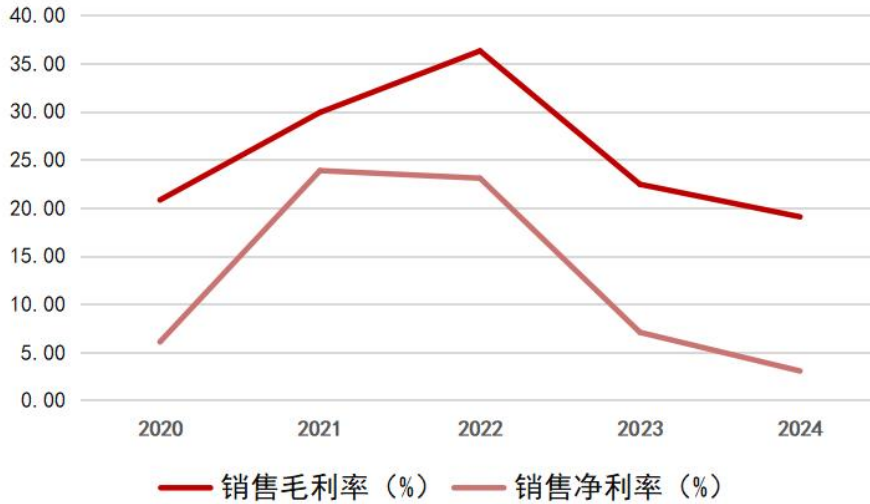
图 51：集成电路制造板块 2020 年—2024 年归母净利润情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

盈利能力：资本开支上升叠加行业竞争加剧，板块 2024 年盈利能力承压。盈利能力方面，集成电路制造板块 2024 年销售毛利率、净利率分别为 19.06%和 3.03%，相比上年同期分别下降 3.38 个百分点和 4.01 个百分点。以内资晶圆代工龙头中芯国际为例，虽然受益行业复苏，公司 2024 年实现晶圆销售数量增长和产品组合优化，带动 2024 年营业收入同比增长 27.7%，其中晶圆代工业务同比增长 30.3%（占总收入 93.2%），但营业成本增幅达 33.1%，高于全年营收增速，导致全年毛利率从 20.8%下降至 18.7%；华虹公司 2024 年晶圆销售数量虽然有所上升，但产品价格下降导致全年营收同比下降 11.36%，叠加在固定资产、无形资产和其他长期资产上的支出同比大幅增长，导致公司全年归母净利润同比下降 80.34%。

图 52：集成电路制造板块 2020-2024 年销售毛利率、净利率



数据来源：同花顺iFind，东莞证券研究所

中芯、华虹 25Q1 业绩展望乐观，内资晶圆厂话语权提升有望拉动上游设备、材料需求。据中芯国际、华虹半导体港股公告及 2024 年业绩说明会信息，两家公司对 2025 年一季度销售指引均乐观积极，其中中芯国际预计 2025 年第一季度销售收入环比增长 6%-8%，毛利率在 19%-21%之间，在外部环境无重大变化的前提下，公司 2025 年全年指引为：销售收入增幅高于可比同业的平均值，资本开支与上一年相比大致持平；华虹半导体预计 2025 年第一季度销售收入约在 5.3 亿美元至 5.5 亿美元之间，相比 2024 年一季度同比增幅在 15%-19.5%，预计 25Q1 毛利率大约在 9%至 11%之间，2024 年第一季度毛利率为 6.4%。

根据芯思想研究院（Chipinsights）数据，2024 年全球 31 家专属晶圆代工厂整体营收为 9,154 亿元，相较 2023 年上涨 23%。其中，中芯国际 2024 年在模拟、图像处理、传感技术和显示技术等优势领域实现了持续的收入增长，全年营收在全球纯晶圆代工厂中位列第二，仅次于台积电。除中芯国际外，中国大陆还有三家晶圆厂进入全球前十，分别为：华虹半导体（全球第五）、晶合集成（全球第九）和芯联集成（全球第十）。近年来，受益于产能扩张、技术进步和政策支持，内资晶圆厂营收不断攀升，话语权逐步提高，对上游国产设备、材料形成拉动作用。

图 53：2024 年专属晶圆代工工厂营收排名（单位：亿元）

2024排名	2023排名	公司	总部	2024年	2024市占率	2023年	2023市占率	年增长率
1	1	台积电TSMC	中国台湾	6476	70.74%	4908	66.05%	31.95%
2	4	中芯国际SMIC	中国大陆	569	6.22%	448	6.03%	27.01%
3	3	联电UMC	中国台湾	509	5.56%	506	6.81%	0.59%
4	2	格芯GlobalFoundries	美国	480	5.24%	524	7.05%	-8.40%
5	5	华虹集团HuaHong Group*	中国大陆	276	3.02%	265	3.57%	4.15%
6	6	力积电Powerchip	中国台湾	104	1.14%	101	1.36%	2.97%
7	7	高塔TowerJazz	以色列	103	1.13%	101	1.36%	1.98%
8	8	世界先进VIS	中国台湾	99	1.08%	88	1.18%	12.50%
9	10	晶合集成Nexchip	中国大陆	92	1.01%	72	0.97%	27.78%
10	11	芯联集成UNT**	中国大陆	58	0.64%	48	0.65%	19.94%
前十大营收				8766	95.76%	7061	95.03%	24.14%
其他营收				388	4.24%	369	4.97%	5.15%
合计营收				9154	100.00%	7430	100.00%	23.20%

资料来源：芯思想研究院（ChipInsights），东莞证券研究所

注 1：华虹集团包括华虹宏力和上海华力

注 2：芯联集成扣除其模组封装收入

注 3：专属晶圆代工营收数据不包括三星、英特尔、SK 海力士等 IDM 的代工营收

部分集成电路制造企业业绩梳理

中芯国际（688981）：公司 2024 年实现营收 577.96 亿元，同比增长 27.72%，实现归母净利润 36.99 亿元，同比下降 23.31%。2024 年，受益半导体强劲复苏，公司营收同比增长 27.7%。其中，晶圆代工业务收入为 53,246.1 百万元，同比增长 30.3%，占总收入的 92.1%，全年中国区收入占比从 80.1%提升至 84.6%，显示本土市场需求强劲。分业务来看，公司来自消费电子领域的收入占比从 25.0%跃升至 37.8%，成为增长的主要驱动力；营业成本方面，公司全年营业成本增幅达 33.1%，高于收入同比增速，主要原因为晶圆销售数量增加、产品组合变动和折旧增加，导致全年毛利率从 20.8%下降至 18.7%，且拖累利润端表现。

3. 投资建议

投资建议：AI 渗透与国产替代趋势明确，维持半导体板块超配评级。受益 AI 驱动需求复苏和关键领域国产替代持续推进，半导体行业自 2023 年下半年以来逐步进入景气复苏周期，且 2024 年、2025 年一季度营收、净利润维持增长态势，盈利能力也从 2024 年下半年开始逐步修复，并于 25Q1 实现同比正向增长。建议从成长空间和长期确定性出发，把握 25Q1 业绩表现较好的半导体设备与材料、AI 算力、AI 终端芯片、模拟芯片、半导体封测等细分板块。

建议关注标的：

半导体设备：北方华创（002371）、中微公司（688012）、华海清科（688120）、长川科技（300604）、盛美上海（688082）；

半导体材料：鼎龙股份（300054）、江丰电子（300666）、雅克科技（002409）；

IC 设计：兆易创新（603986）、澜起科技（688008）、佰维存储（688525）、乐鑫科技（688018）、圣邦股份（300661）、思瑞浦（688536）、韦尔股份（603501）、思特威

(688213)、海光信息(688041)；

晶圆代工与半导体封测：中芯国际(688981)、长电科技(600584)、通富微电(002156)。

4. 风险提示

(1) **终端需求不及预期：**智能手机、PC 构成半导体的主要下游应用领域之一，若后续下游需求持续性不及预期，则可能对相关上市公司业绩造成不利影响；

(2) **国产替代不及预期：**若半导体设备、材料等企业技术突破不如预期导致国产替代进程受阻，则可能面临业绩增速放缓的风险；

(3) **价格竞争加剧：**若业内上市企业进行大量产能扩张，则行业未来可能面临产能过剩的局面，带来价格竞争导致盈利能力下滑的风险。

表 1：重点公司盈利预测及投资评级（截至 2025/5/8）

股票代码	股票名称	股价 (元)	EPS (元)			PE (倍)			评级	评级变动
			2024A	2025E	2026E	2024A	2025E	2026E		
002371	北方华创	448.89	10.56	14.29	18.15	134.64	31.41	24.73	买入	维持
688012	中微公司	190.07	2.60	3.81	5.20	135.64	49.86	36.56	买入	维持
688120	华海清科	165.11	4.31	5.74	7.25	136.64	28.76	22.79	买入	维持
300604	长川科技	42.86	0.72	1.34	1.81	137.64	32.04	23.71	买入	维持
688082	盛美上海	106.55	2.61	3.58	4.47	138.64	29.77	23.84	买入	维持
300054	鼎龙股份	29.68	0.55	0.73	0.94	139.64	40.45	31.59	买入	维持
300666	江丰电子	77.85	1.51	1.97	2.57	140.64	39.53	30.34	买入	维持
002409	雅克科技	56.59	1.83	2.50	3.24	141.64	22.62	17.49	买入	维持
603986	兆易创新	127.52	1.66	2.40	3.13	142.64	53.21	40.69	买入	维持
688008	澜起科技	77.83	1.25	1.72	2.33	143.64	45.25	33.40	买入	维持
688525	佰维存储	64.72	0.37	1.24	1.79	144.64	52.25	36.10	买入	维持
688018	乐鑫科技	215.70	3.07	4.11	5.57	145.64	52.53	38.70	买入	首次
300661	圣邦股份	99.45	1.06	1.48	2.26	146.64	67.20	44.00	买入	维持
688536	思瑞浦	150.72	-1.50	1.00	2.33	147.64	151.13	64.71	买入	维持
603501	韦尔股份	131.36	2.77	3.70	4.79	148.64	35.50	27.42	买入	维持
688213	思特威	98.88	0.98	2.08	3.12	149.64	47.45	31.65	买入	维持
688041	海光信息	146.00	0.83	1.34	1.92	150.64	108.61	76.00	买入	维持
688981	中芯国际	89.98	0.46	0.65	0.85	151.64	139.33	106.20	买入	维持
600584	长电科技	34.27	0.90	1.32	1.72	153.64	25.96	19.92	买入	维持
002156	通富微电	26.30	0.45	0.73	0.94	154.64	36.26	27.95	买入	维持

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

注：除北方华创、澜起科技、圣邦股份、韦尔股份、长电科技外，其他公司 2025/2026 年 EPS 采用同花顺一致预测值

东莞证券研究报告评级体系：

公司投资评级	
买入	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 15%以上
增持	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 5%-15%之间
持有	预计未来 6 个月内，股价表现介于市场指数±5%之间
减持	预计未来 6 个月内，股价表现弱于市场指数 5%以上
无评级	因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，导致无法给出明确的投资评级；股票不在常规研究覆盖范围之内

行业投资评级	
超配	预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 10%以上
标配	预计未来 6 个月内，行业指数表现介于市场指数±10%之间
低配	预计未来 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

说明：本评级体系的“市场指数”，A 股参照标的为沪深 300 指数；新三板参照标的为三板成指。

证券研究报告风险等级及适当性匹配关系

低风险	宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告
中低风险	债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告
中风险	主板股票及基金、可转债等方面的研究报告，市场策略研究报告
中高风险	创业板、科创板、北京证券交易所、新三板（含退市整理期）等板块的股票、基金、可转债等方面的研究报告，港股股票、基金研究报告以及非上市公司的研究报告
高风险	期货、期权等衍生品方面的研究报告

投资者与证券研究报告的适当性匹配关系：“保守型”投资者仅适合使用“低风险”级别的研报，“谨慎型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中低风险”的研报，“稳健型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中风险”的研报，“积极型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中高风险”的研报，“激进型”投资者适合使用我司各类风险级别的研报。

证券分析师承诺：

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地在所知情的范围内出具本报告。本报告清晰地反映了本人的研究观点，不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系，没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益，或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。

声明：

东莞证券股份有限公司为全国性综合类证券公司，具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供东莞证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可跌可升。本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。在任何情况下，本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并不构成对任何人的投资建议。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、经纪、资产管理等服务。本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有，未经本公司事先书面许可，任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登。如引用、刊发，需注明本报告的机构来源、作者和发布日期，并提示使用本报告的风险，不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本证券研究报告的，应当承担相应的法律责任。

东莞证券股份有限公司研究所

广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 24 楼

邮政编码：523000

电话：(0769) 22115843

网址：www.dgza.com.cn